

## JEITA 電子実装技術標準化 活動報告会2019

～ ソサイエティ5.0実現に向けた電子実装技術の未来 ～

日時 2019年7月2日(火) 10:00～17:00 (受付開始 9:30～)

場所 機械振興会館 ホール(地下2階)

主催 一般社団法人 電子情報技術産業協会

企画 JEITA/実装技術標準化専門委員会

## Program

司会 山田 浩 JEITA 実装技術標準化専門委員会 副委員長 (株)東芝

10:00～10:05	主催者挨拶 二宮 良次 実装技術標準化専門委員会 委員長 東芝デバイス&ストレージ(株)
10:05～10:10	来賓挨拶 藤井 宏信 氏 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 電子デバイス係長

## 第1部 -日本の国際標準化戦略-

10:10～10:40	経済産業省の最新の標準化政策について 中野 宏和 氏 経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課 課長
10:40～11:00	IEC/TC91 Role and Activities 岡本 正英 IEC/TC91 国際幹事 (株)日立製作所

## 第2部 -電子実装技術(IEC/TC91)での国際標準化活動-

11:00～11:20	IEC 61189-5-601「はんだ接合部のリフローはんだ付け性およびプリント配線板のリフロー耐熱性試験方法」 杉野 成 IEC/TC91 WG3エキスパート 富士通アドバンステクノロジー(株)
11:20～11:40	IEC 60068-2-82「電気・電子部品のウイスカ試験方法」 坂本 一三 IEC/TC91 WG3エキスパート オムロン(株)
11:40～12:00	METIプロジェクト「三次元電子モジュールに関する国際標準化」 春日 壽夫 IEC/TC91 WG6コンベナー 基準認証イノベーション技術研究組合
12:00～12:20	METIプロジェクト「パワーデバイス実装に関する接合耐久性試験方法の国際標準化」 山本 剛 IEC/TC91 WG3エキスパート 富士通アドバンステクノロジー(株)

休憩 (昼食は各自にてお願い致します。)

## 第3部 -次世代パワーデバイス実装に関する国際標準化(METIプロジェクト)-

13:20～13:35	METIプロジェクト「電力半導体デバイス接合部の国際標準化」の概要 苅谷 義治 国際標準化研究委員会 委員長 芝浦工業大学 教授
13:35～14:00	「電力半導体デバイス接合部の国際標準化」システムソルダリングWGの成果 高橋 浩之 国際標準化研究委員会 副委員長 (株)東芝
14:00～14:25	「電力半導体デバイス接合部の国際標準化」ニアチップボンディングWGの成果 西川 宏 国際標準化研究委員会 副委員長 大阪大学 教授

休憩

## 第4部 -JEITA 実装技術標準化専門委員会 最新活動トピックス報告-

14:35～14:50	JEITA 電子実装技術専門委員会の標準化概要 二宮 良次 JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 東芝デバイス&ストレージ(株)
14:50～15:05	JEITA「はんだ付け試験標準化G」の活動について 諏訪 正樹 はんだ付け試験標準化G 主査 KOA(株)
15:05～15:20	JEITA「電子部品のリフロー加熱中の反り量および反り測定方法の要求事項標準化PG」の活動について 林田 真人 電子部品のリフロー加熱中の反り量および反り測定方法の要求事項標準化PG 主査 ソニーGM&O(株)
15:20～15:35	JEITA「In含有はんだ低温実装品でのSnウイスカ」 斎藤 彰 JEITA ウイスカ試験方法研究会 副主査 (株)村田製作所

休憩

15:45～16:00	JEITA「実装CADライブラリ&データフォーマット標準化G」-実装設計技術の標準について 小島 智 実装CADライブラリ&データフォーマット標準化G 主査 コジマイーデザインオフィス
16:00～16:15	JEITA「部品内蔵型三次元実装技術標準化G」の活動について 春日 壽夫 三次元実装技術標準化G 主査 基準認証イノベーション技術研究組合
16:15～16:30	JEITA「サーマルマネジメント標準化検討G」-基板放熱型熱設計のためのインフラ整備 平沢 浩一 JEITA サーマルマネジメント標準化検討G 副主査 KOA(株)
16:30～16:45	IEC/TC91国内委員会「低温ソルダペーストについて」 鶴田 加一 IEC/TC91 WG3エキスパート 千住金属工業(株)
16:45～16:55	講評 山本 克己 氏 経済産業省 産業技術環境局国際電気標準課 課長補佐
16:55～17:00	閉会挨拶 反保 昌博 実装技術標準化専門委員会 副委員長 (株)村田製作所

## ご挨拶

当協会では、「実装技術標準化専門委員会」を中心に1997年からはんだの鉛フリー化に代表されます、環境に配慮した実装技術開発活動に取り組んで参りました。また、これらの活動成果は、毎年『報告会』を開催し、広く普及を図って参りました。今年も『JEITA 実装技術標準化専門委員会 成果報告会』として、この一年間の先端的な実装技術の検討結果をご報告させていただきます。

今回は、産業全体にかかわる動向のご紹介として、最新の標準化政策について経済産業省からご講演をいただき、その後、実装技術標準化にかかわる活動として、METIプロジェクト「三次元電子モジュールの外形及び電氣的試験方法に関する国際標準化」および「パワーデバイス実装に関わる接合耐久性試験方法の国際標準化」をはじめ、はんだ接合部のリフローはんだ付け性に係る標準化、電気・電子部品のウィスカ試験方法について等、多岐にわたるテーマについてご報告させていただきます。

また、実装技術標準化専門委員会での取り組みとして、近年課題としてクローズアップされてきています電子部品のリフロー加熱中の反り量および反り測定方法に関する要求事項の標準化や、実装CADライブラリおよびデータフォーマットの標準化、熱問題に関する標準化への取り組みについての報告も行わせていただきます。関係各位におかれましてはご多用中とは思いますが、是非ご参加いただき、忌憚のないご意見、活発なご討論を賜りますようお願い申し上げます。

JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 二宮 良次〔東芝デバイス&ストレージ(株)〕

■日 時 2019年7月2日(火) 10:00~17:00 (受付開始9:30~)

■場 所 機械振興会館 ホール(地下2階)  
東京都港区芝公園3-5-8  
<http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html>

■申込方法 下記のURLに必要事項を入力してください。  
折り返し「参加受付完了メール」が自動送信されます。  
当日、本メールをプリントアウトの上、会場受付にご提示ください。  
また、ご登録の宛先に「請求書」をお送り致します。  
[https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/form\\_tss/form.cgi](https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/form_tss/form.cgi)

■申込期限 2019年6月27日(木) 必着

■定 員 200名  
(定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。)

■参加費 会員 10,000円(税込)  
一般 15,000円(税込)

■配布資料 活動報告書(当日配布致します。)

■お問合せ先 一般社団法人 電子情報技術産業協会  
標準化戦略室(北田・澤田)  
TEL:03-5218-1059 FAX:03-5218-1078  
E-mail:k-kitada@jeita.or.jp

## 会場へのアクセス



## 最寄駅のご案内：

東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩8分  
都営地下鉄三田線「御成門駅」徒歩8分  
都営地下鉄浅草線「大門駅」徒歩10分  
JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」徒歩15分

※お申込み時に入力いただきました個人情報は、本セミナーの受付、次回ご案内のために使用致します。  
他の目的で使用することはありません。

※JEITAの個人情報保護方針につきましては、以下をご参照ください。

<https://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/>